

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2024-055

通富微电子股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通富微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”或“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为提升公司治理质量和投资价值，提振投资者信心，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下：

一、专注主业，深耕集成电路封装测试领域

公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。

公司坚持“以人为本，产业报国，传承文明，追求高远”的企业文化，贯彻“诚信、客户导向、承诺、创新”的企业文化核心价值观，为客户提供“一站式解决方案”，努力建设成为世界级的集成电路封测企业。公司以超前的意识，主动融入全球半导体产业链，积累了多年国际市场开发的经验，使得公司可以更了解不同客户群体的特殊要求，进而针对其需求进行产品设计并提供相应高质量的服务。公司客户资源覆盖国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业，同时，公司通过并购与 AMD 形成了“合资+合作”的强强联合模式，建立了紧密的战略合作伙伴关系。

公司不断优化产品结构和客户结构，提升公司核心竞争力和盈利能力，努力为股东创造更多价值。公司扬长补短，积极调整产业布局，不断技术创新，加强管理，持续服务好大客户，公司的苏州工厂与槟城工厂不断强化与国际大客户等行业领先企业的深度合作，进一步扩大先进产品市占率，在市场、人力、营运等各方面收获良好的效益。2023年，公司实现营业收入222.69亿元，同比增长3.92%。根据芯思想研究院发布的2023年全球委外封测榜单，在全球前十大封测企业2023年营收普遍下降的情况下，公司营收略有增长。2024年第一季度，公司实现营业收入52.82亿元，较上年同期增长13.79%；实现归属于上市公司股东的净利润0.98亿元，较上年同期增长2,064.01%。2024年上半年，公司积极进取，产能利用率提升，营业收入增幅明显上升；同时，得益于加强管理及成本费用的管控，公司整体效益显著提升。预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利28,800万元至37,500万元，同比上年增长253.44%-299.79%。

未来，公司将持续专注于集成电路封测，努力提升产品的设计研发、品质控制、市场营销、资源整合等四种核心能力，逐步靠实力、业绩、贡献树立起“通富微电”品牌。公司奉行长期主义的战略定力与艰苦奋斗的实干精神，鼓舞全体员工不断进步，追求卓越。未来我们的目标是，突破固有思维，挑战不可能；强化复盘管理，打造学习型组织；加快实现高水平科技自立自强，推动企业高质量发展，以能力的确定性应对外部环境的不确定性。

二、持续加大研发投入，发展新质生产力

公司坚持自主研发，建有国家认定企业技术中心、国家级博士后科研工作站、江苏省企业院士工作站、省集成电路先进封装测试重点实验室、省级技术中心和工程技术研究中心等高层次创新平台，拥有一支专业的研发队伍，先后与中科院微电子所、中科院微系统所、清华大学、北京大学、华中科技大学等知名科研院所和高校建立了紧密的合作关系，并聘请多位专家共同参与新产品新技术的开发

工作。

作为国家高新技术企业，公司在发展过程中不断加强自主创新，先后承担了多项国家级技术改造、科技攻关项目，并取得了丰硕的技术创新成果。超大尺寸 2D+封装技术及 3 维堆叠封装技术均获得验证通过；大尺寸多芯片 chip last 封装技术获得验证通过；国内首家 WB 分腔屏蔽技术研发及量产获得突破。2021 年，公司作为主要参与完成单位、石磊总裁作为主要完成人的《高密度高可靠电子封装关键技术及成套工艺》项目喜获国家科技进步一等奖。

最近三年（2021 年至 2023 年），公司累计研发投入 35.47 亿元，占同期营收的比重为 5.96%。同时，公司在多个先进封装技术领域积极开展国内外专利布局。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计国内外专利申请达 1,544 件，先进封装技术布局占比超六成；公司先后从富士通、卡西欧、AMD 获得技术许可，使公司快速切入高端封测领域，为公司进一步向高阶封测迈进，奠定坚实的技术基础。

今年“两会”期间，习总书记指出，要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力。通富微电作为集成电路封测领域的龙头企业，在生产经营中一直践行发展新质生产力的理念。2024 年，公司将在集成电路行业机遇与挑战并存的复杂环境下，控制传统封装资本开支，大力扩张先进封装规模，牢牢抓住产业机会，把握战略机遇期，从量的蓬勃发展，调整为量的适度增长以及质的全面提升，公司继续以发展新质生产力为抓手，提升传统产品竞争力，大力发展新兴产品，谋划布局未来产品，以创新驱动发展，以科技引领未来，从而全面实现通富高质量发展的战略目标。

三、重视投资者回报，现金分红保障股东共享公司发展成果

提高公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是公司发展中的核心要务。公司持续践行“以投资者为本”的发展理念，高度重视对投资者的合理投资回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报。公司遵照

相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，并结合公司实际发展、未来规划等情况，制定合理的分红方案。公司最近三年（2021年至2023年）向股东分配的现金红利超人民币1.6亿元。

2024年，公司将继续聚焦主营业务，全面提升经营质量，构建企业的可持续发展，秉承积极回报投资者的发展理念，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红的关系，在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红方案，与广大投资者共享公司发展成果。

四、加强投资者沟通，传递公司价值

公司深知在快速发展的半导体行业中，加强与投资者的深度沟通、提高信息披露质量是构建长期信任与共赢关系的关键。为此，公司始终秉持积极、及时的原则，不断优化投资者关系管理体系，致力于通过多渠道、多形式的沟通方式，确保所有投资者都能公平、准确地获取公司的经营动态、财务状况、战略规划及重大事项进展等核心信息。

公司积极组织定期及不定期的投资者调研、业绩说明会等活动，还通过深交所互动易、投资者热线与邮箱、公司官网等方式听取并回应投资者的关切与问询，搭建起公司与投资者之间高效互动的桥梁。

未来，我们将继续深化投资者关系管理，以更加专业的姿态，加强与投资者的沟通，推动公司高质量发展，也将积极探索ESG（环境、社会与治理）信息披露的新模式，积极响应全球可持续发展趋势，展现公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的实践与成果，让更多关注可持续发展的投资者更加了解公司，公司坚持与广大投资者携手并进，共创辉煌。

五、完善公司治理，坚持规范运作，提高信息披露质量

我们始终致力于完善公司治理结构，坚持规范运作的原则，深入优化内控管

理体系，有效降低各环节风险水平，为公司股东合法权益提供有力保障；同时，不断提升信息披露的质量。良好的公司治理是企业持续健康发展的基石，而规范运作则是维护投资者权益、增强市场信任的关键。因此，公司不断优化内部管理体系，强化董事会、监事会的职能与独立性，确保决策过程的科学与民主。2024年上半年，公司共召开六次董事会、五次监事会及两次股东大会。公司全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，积极关注公司经营情况，促进三会的合规高效运行。2024年上半年，公司严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，不断优化、完善公司治理结构，及时对内控制度中有关条款的变动进行修订及完善，累计修订了包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度在内的12项制度规则。

同时，我们高度重视信息披露工作，严格遵守相关法律法规和监管要求，确保信息的真实性、准确性、完整性和及时性，为投资者提供清晰、全面的公司运营状况和发展前景。公司已连续多年在深圳证券交易所年度信息披露考评中获得“A级”。通过这些努力，我们旨在构建一个高效、负责任的企业形象，与投资者携手共创美好未来。

六、 其他事项

公司将积极响应“质量回报双提升”专项行动，进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。同时，公司将继续坚持以投资者为本，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、高质量的信息披露和积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

本次行动方案是基于公司目前经营情况和外部环境做出的，未来可能会受到政策调整、行业发展、国内外市场环境等因素的影响。方案所涉及的公司规划、发展战略等是非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请

投资者注意相关风险。

特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会

2024年8月26日